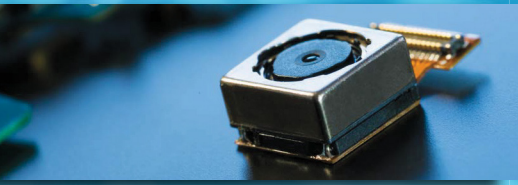
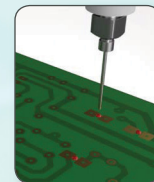


ŘEŠENÍ ALPHA® HITECH™ PRO SPOLEHLIVOU ADHEZI

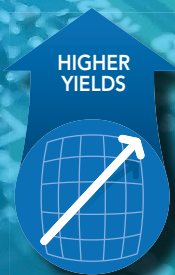
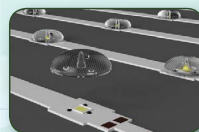


Lepidla ALPHA® HiTech™ lze použít pro široké spektrum aplikací vyžadujících uchycení čipových součástek na místě nebo lepení zařízení při různých podmínkách vytvrzování

Lepidla ALPHA® HiTech™ SMD jsou lepidla s rychlým tepelným vytvrzováním pro povrchové lepení pro použití ve vysokorychlostních dávkovačích a při sítotisku. Jsou určena k uchycení součástek na povrchu během měkkého pájení vlnou.



Nízkoteplotní lepidla ALPHA® HiTech™ jsou určena k lepení zařízení citlivých na teplotu s různými plastovými a kovovými povrchy, která se používají při montáži kamerových modulů. Tato řada produktů zajišťuje vynikající adhezi a odolnost vůči nárazům při pádu.



UV lepidla ALPHA® HiTech™ mají složení upravené pro vytvrzování ultrafialovým zářením při teplotě prostředí. Tyto produkty lze používat u součástek, které vyžadují vysokou pevnost v tahu a odolnost vůči vlhkosti.

